



Innovative Entwicklung bei Sauter Elektronik 2006 bis 2009

Wir sind ein expandierendes Unternehmen im Dienstleistungsbereich mit Schwerpunkt LEITERPLATTENBESTÜCKUNG (EMS). Wir bieten Ihnen einen umfangreichen Service von der Material-Bestellung über die Fertigung bis hin zum Versand. Auch große Stückzahlen werden dank eigener Produktion mit hochmodernen Fertigungslinien in höchster Qualität wettbewerbsfähig realisiert. Unser hoch technischer Maschinenpark wird stets an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet:

❑ SMD Bestückung



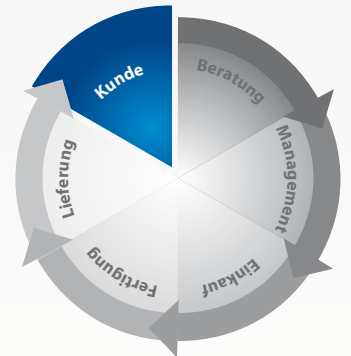
SMD-Bestückungsmaschinen

Insgesamt stehen Ihnen 13 Mydata SMD-Bestückungsmaschinen zu Verfügung. Darunter SMD-Bestückungsautomaten, die die 30.000 BT/h-Grenze überschreiten und das gesamte Bauteilspektrum abdecken. Kleinstelemente wie 0201 können ebenso bestückt werden wie große BGA bis zu einer Kantenlänge von 55 mm.



SMD-Schablonenreinigung Kolb

Kolb PS07 ST ist ein High End Reinigungssystem mit Volumen Druck-Sprüh-Technologie, das in kurzer Taktzeit exzellente Reinigungsergebnisse an Ihrer Druckschablone liefert. Gleichbleibende Parameter erhöhen die Qualität des SMD Pastendruckes deutlich.



❑ SMD Lötssysteme

Dampfphasen Lötanlagen ASSCON VP56 und VP2000

Das Dampfphasenlöten nutzt zur Erwärmung der Baugruppen die bei der Phasenänderung des Wärmeträgermediums (vom gasförmigen in den flüssigen Zustand) freigesetzte Wärme (latente Wärme). Diese Kondensation findet solange an der gesamten Oberfläche des Lötgutes statt, bis die Baugruppe die Temperatur des Dampfes erreicht hat. Aufgrund der hohen Dampfdichte findet der gesamte Erwärmungsprozess in einer sauerstofffreien Umgebung statt. Die Wärme gelangt dadurch an die kritischen Stellen Ihrer QFN und BGA Baugruppen.



Reflow-Lötssystem SMD Quattro Peak® M (N2)

Mit diesem modernen SMD Reflow-Lötssystem gewährleisten wir Ihnen optimale Prozesssicherheit, optimale Wärmeübertragung und eine Vorbeugung des Oxidationsprozesses.

❑ SMD Reparatur



ERSASCOPE Kontrollsystem

Das ERSASCOPE liefert klare Bilder von verdeckten Lötstellen, insbesondere bei BGA und QFN. Dies garantiert eine schnelle und präzise Inspektion.



BGA, QFN und QFP Reworksystem

Die Nacharbeit oder Reparatur von elektronischen Bauteilelementen verlangt technisch aufwendige Maschinen und geschulte Mitarbeiter. Ein temperaturgerechter Umgang mit den BGA, QFN und QFP-Bauteilen ist immer gewährleistet.

■ SMD Kontrolle



AOI (Automatische Optische Inspektion) ORBOTECH Vantage S22

Unser AOI Bereich wurde um 2 weitere ORBOTECH Vantage S22 erweitert. Diese Systeme dienen nach dem Reflow-Prozess zur Verbesserung der Produktqualität und der Steigerung der Produktivität. Spezielle Techniken zur Bilderkennung und Bildverarbeitung sorgen für die Erfassung und Analyse aller sichtbaren Fehler an Bauteilen und Lötstellen einschließlich abgehobener Draht-, Fine-Pitch-Anschlüssen. Die Fehlerquote an Ihrer Baugruppe sinkt durch diese Investition auf ein Minimum.

■ THT Lötssysteme



ERSA Doppel-Selektivlötanlage

Die ERSA VERSAFLOW 5060 besteht aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden und programmierbaren Modulen. Einem Präzisions-Multi-Drop-Fluxer, der über ein X-Y-Achsensystem bewegt wird, einem fest installierten Vorheizmodul und einem Lötmodul, das über ein X-Y-Z-Achsensystem positioniert und bewegt wird. Um die Oxydbildung im Lötmodul zu reduzieren und um die Lötqualität zu verbessern, wird das Lötmodul mit Schutzgas geflutet. THT Bauteile können ein- bzw. zweiseitig eingelötet werden.

SEHO 400mm MWS 2340 bleifrei Vollstickstoff Wellenlötanlage

Durch die von SEHO entwickelte, weltweit führende Stickstofftechnologie, die leistungsstarke Maschinenausstattung und den modularen Aufbau der Anlage, ist das Stickstoff Wellenlötssystem MWS 2340 ideal für das Löten Ihrer anspruchsvollen Leiterplatten. Ein Kühlaggregat kann zugeschaltet werden, um ein Überhitzen Ihrer Baugruppen vermeiden zu können. Mit Transpondern werden die verschiedenen Parameter auf einzelne Lötrahmen übertragen. Unsere bleifrei Lötanlage kann so individuell auf Ihre Anforderungen angepasst werden.



■ Lackierung und Verguss



Asymtek Lackieranlage

Um einer Oxidation vorbeugen zu können, haben wir eine inline Asymtek C-740 Lackieranlage in unseren Leistungsumfang aufgenommen. Ihre Baugruppen werden mit Peters SL1305AQ/25-ECO-FLZ einer gleichbleibend dicken Lackschicht überzogen. Andere Lacke können auf Anfrage auch gerne verarbeitet werden. Um Ihre Baugruppen mit empfindlichen Bauteilen vor Erschütterungen zu schützen, können diese auf Wunsch auch vergossen werden.

■ Lagertechnik



Asys MSL-Level Trockenschrank

Kontrolliertes Trocknen und Umwälzen der im Schrank befindlichen Luft mit einem leistungsfähigen Adsorptionstrockner. Geschlossenes Umluftsystem mit hohen Luftumwälzungsraten. Zusätzliches Heizmodul bis max. 40°C zur stressfreien Bauteiltrocknung. Darin werden Ihre feuchten und schmutzempfindlichen Bauelemente und Baugruppen unter trockener Atmosphäre kleiner 3% relativer Feuchte eingelagert.



Kardex Shuttle System mit 15m Höhe über 3 Stockwerke

Das KARDEX Shuttle XP ist ein automatisiertes Hochregallager in modularer Bauweise, das nach dem Prinzip „Ware zur Person“ arbeitet. Auf minimaler Grundfläche wird die maximale Höhe ausgenutzt. Die Waren werden nach einer chaotischen Lagerhaltung abgelegt, so dass sie schnell eingelagert und entnommen werden können. Die chaotische Lagerhaltung ermöglicht die Optimierung der Nutzung der Lagerfläche und der Wege. Die Aufzeichnung erfolgt automatisch durch das Lagerverwaltungssystem, das auch für die Zuweisung eines Lagerplatzes mittels Barcode verantwortlich ist.

